

专题文章

每期专题文章均聚焦于我们高科技行业的重大话题。这些文章指出发展趋势和方向，并分析出可行的方案和解决方法。以下是我们每期专题文章的主题覆盖领域，以及专题文章范例。如需了解2009年专题报道计划，敬请查阅我们的社论与展会日程安排。

测试与测量

- 1 购置翻新设备
- 2 测试软件许可
- 3 VXI测试设备
- 4 测试夹具与测试架
- 5 ATE测试设备

印刷电路板设计

- 1 CAD/CAM设计
- 2 裸板制造
- 3 嵌入式元件
- 4 导电墨水与箔片
- 5 可制造性设计

表面贴装技术/电子制造服务

- 1 自动贴片机设备
- 2 送料器
- 3 配带与配盘
- 4 备料（形成引脚、折弯、修整等）
- 5 清洗与环境

元器件与分销

- 1 网络
- 2 电阻与电容
- 3 继电器/变压器/线圈
- 4 终端与组件
- 5 最新趋势信息
- 6 电子分销中的成功案例

分销封装

- 1 半导体封装
- 2 封装元器件
- 3 封装与设计
- 4 裸芯片与封装元件
- 5 密封元件与组件

表面贴装技术 (SMT) 与组件

- 1 丝网切割
- 2 自动印刷
- 3 丝网印刷化学用品
- 4 新型丝网
- 5 清洗与环境

表面贴装技术 (SMT) 与生产

- 1 回流焊设备
- 2 返工工作台
- 3 化学制品与材料
- 4 手动工具
- 5 清洗与环境

重印:

对您的文章进行重印是对产品和服务进行营销的一种有效而经济的方式。请与我们联系或贵公司负责《美国科技》广告的客户经理联系索取报价。

投稿或合作投稿指南:

欲代表贵公司投稿，请通过 wgsalm@gmail.com 与我们的编辑 **Walter Salm** 联系。同时，您也可参考我们“投稿指南”中所要求的具体信息，请在 www.us-tech.com 上查询。